

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(11)実用新案出願公開番号

実開平4-102588

(43)公開日 平成4年(1992)9月3日

(51)Int.Cl.⁵

H 01 R 23/68
9/09
11/01

識別記号 303 Z 6901-5E
9/09
C 6901-5E
A 7004-5E

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全3頁)

(21)出願番号

実開平3-3623

(22)出願日

平成3年(1991)2月4日

(71)出願人 390005175

株式会社アドバンテスト
東京都練馬区旭町1丁目32番1号

(72)考案者 川口 勝三郎

東京都練馬区旭町1丁目32番1号 株式会
社アドバンテスト内

(72)考案者 斎藤 忠男

東京都練馬区旭町1丁目32番1号 株式会
社アドバンテスト内

(74)代理人 弁理士 草野 韶

(54)【考案の名称】 多層配線基板の外部との接続構造

(57)【要約】

【目的】 多層配線基板の内層配線を外部と接続するた
めの多層配線基板表面上の占有面積をなくし基板の面積
を本来の目的のパターンに有効に使う。

【構成】 多層配線基板11の側面を接続面20とし接
続面20に内層配線14の接続線21a, 21b, …の
端を露出させて露出端面22a, 22b, …とし、接続
面20にコネクタが圧接される。

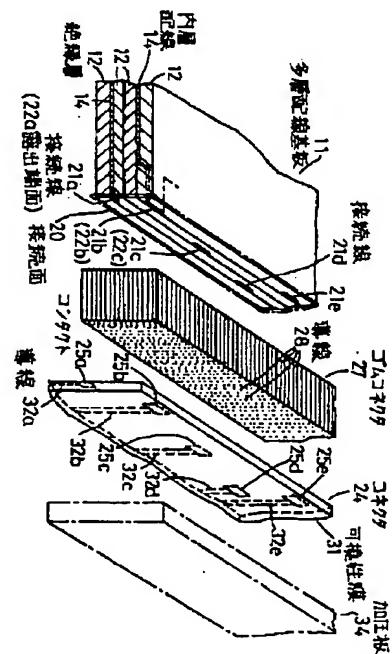


図1

1

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項 1】 多層配線基板の外部との接続構造において、前記多層配線基板の側面の少くとも一部は比較的なめらかな面状の接続面とされ、前記多層配線基板の内層配線に接続線の一端が接続され、その接続線の他端面が前記接続面に露出され、その接続面にコネクタが圧接されていることを特徴とする多層配線基板の外部との接続構造。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この考案の実施例を示す分解斜視図。

10

2

【図 2】 この考案を一部に適用した IC ウェーハ試験用プローブカードを示す縦断面説明図。

【図 3】 絶縁フィルム 44 の展開平面図。

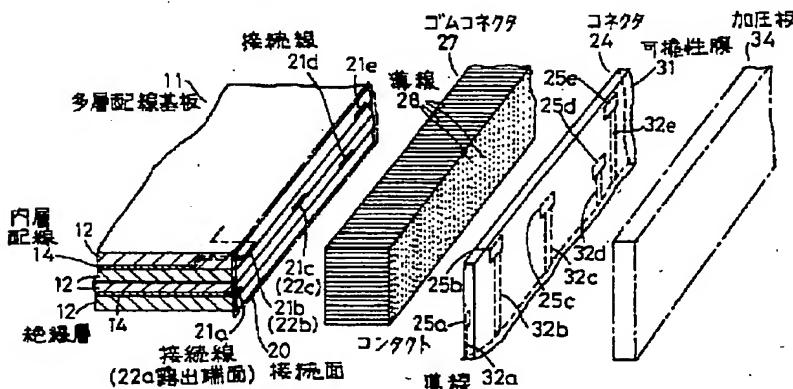
【図 4】 この考案の他の実施例を示し、図 2 における A 部の拡大分解斜視図。

【図 5】 従来の外部との接続構造をもつ多層配線基板を示し一部を断面で表した斜視図。

【図 6】 従来の外部との接続構造をもつ他の多層配線基板を示し一部を断面で表した斜視図。

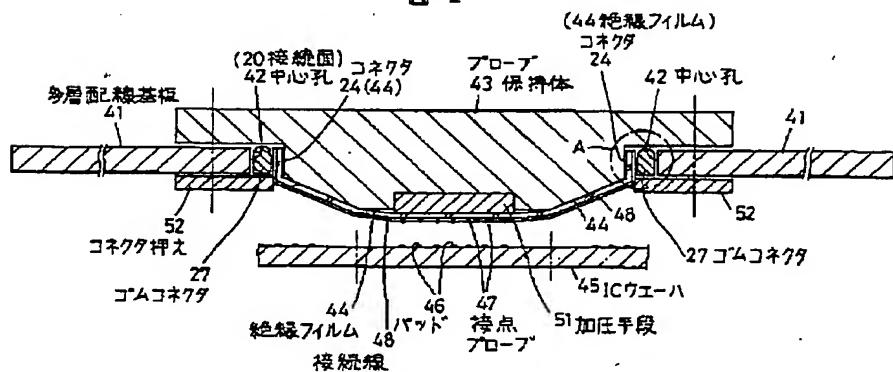
【図 1】

図 1

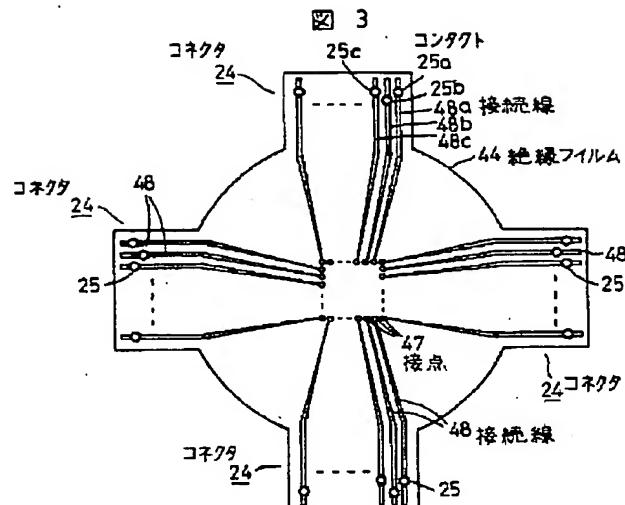


【図 2】

図 2

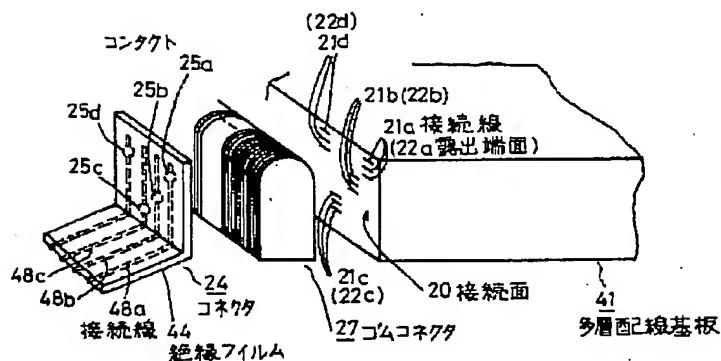


【圖 3】



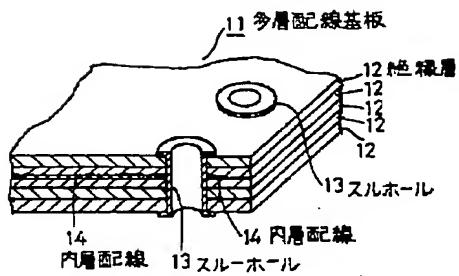
[图4]

四 4



[図 5]

5



〔圖6〕

6

